



Laboratorio de Electrónica General (I)

Jorge Nácher Arándiga
Jornadas Técnicas IFIC 2020, 12 de Marzo de 2020



Quiénes somos

Laboratorio de Electrónica General



- Manuel López. Temporal (hasta junio 2020) CSIC



- Jorge Nácher. Laboral Indefinido no fijo CSIC



Qué hacemos

Dar soporte técnico a proyectos de investigación en cualquier cosa relacionada con Electrónica

- Fabricación de tarjetas prototipo (hasta 6 capas mediante la utilización de maquina microfresadora, CNC laser, Pick&place, prensa multicapa)
- Ensamblado de componentes (automático, manual, horno, ...)
- Reparación mediante manejo de las siguientes herramientas: osciloscopio, fuentes alimentación, microscopio, estaciones de soldadura/desoldadura.



Rework BGA's



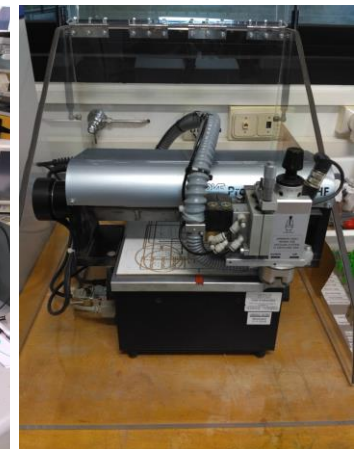
Pick&Place



CNC Láser



Micro



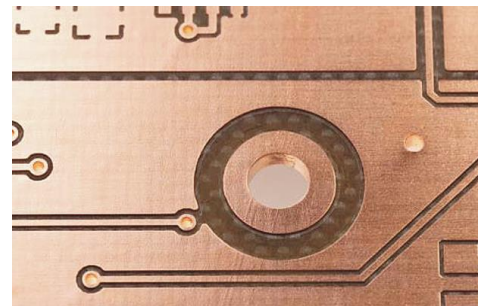
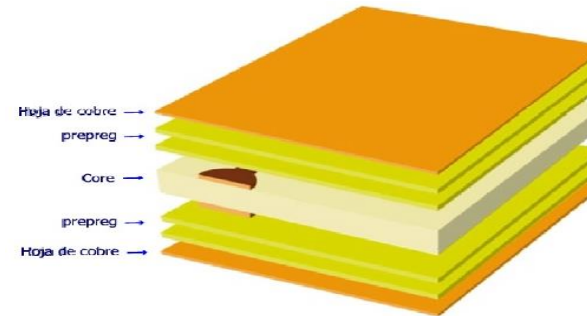
Microfresadora



Fabricación de placas de circuito impreso con CNC

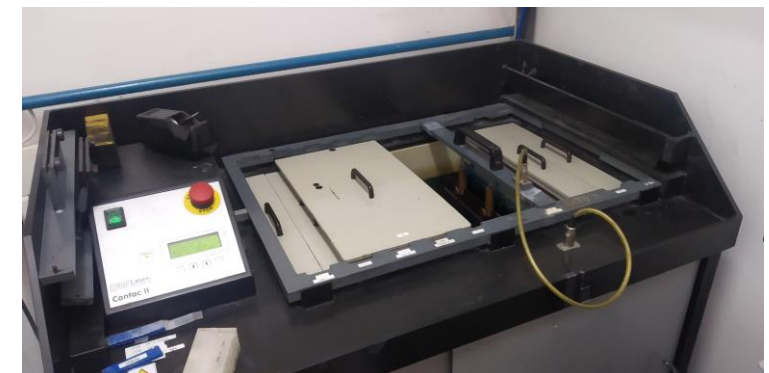


- 1, 2, 4 y 6 capas, en FR4, cem3, duroid, etc.



- Metalización de vías de pcbs

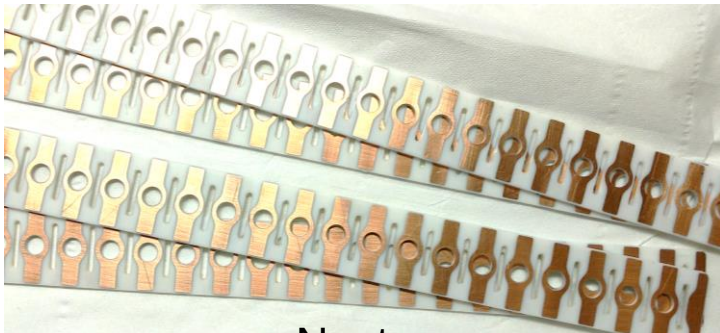
- Prensado multicapa



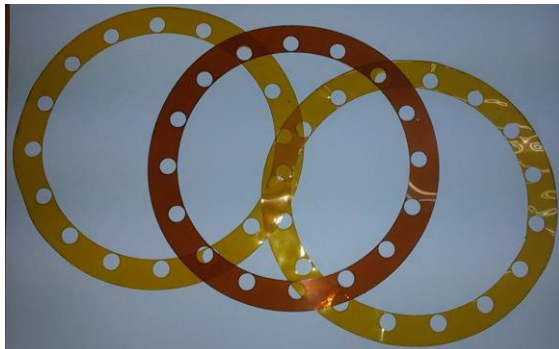
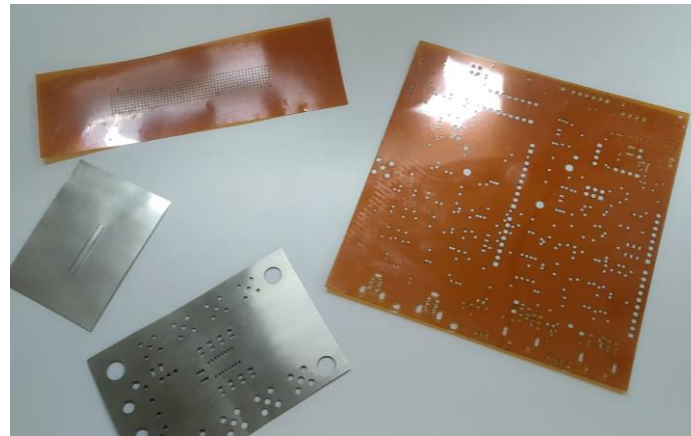


CNC láser

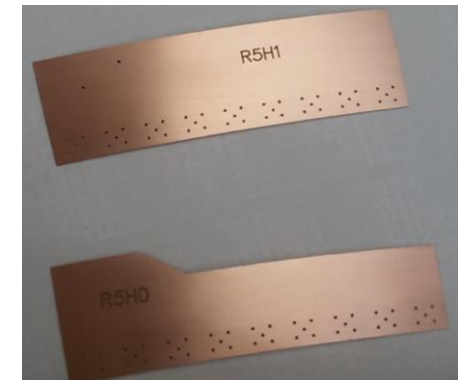
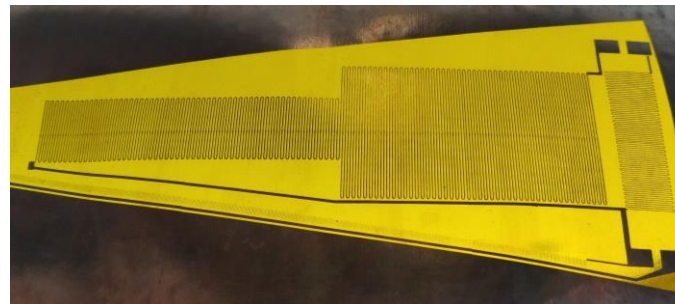
- Fabricación de circuitos en fr4 semiflexible, cuflon, cerámico
- Corte de kapton
- Corte de otros materiales, stencils, etc
- Máscaras de soldadura



Next



Dune

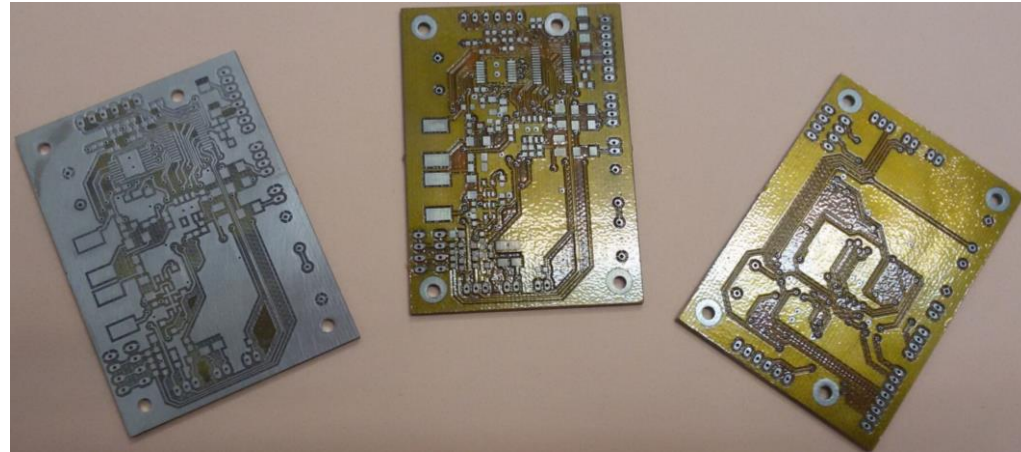


Atlas

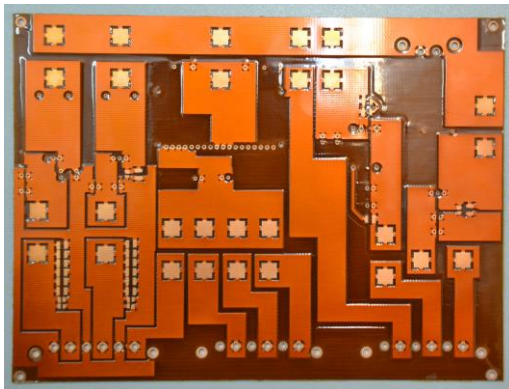


Acabados de tarjetas

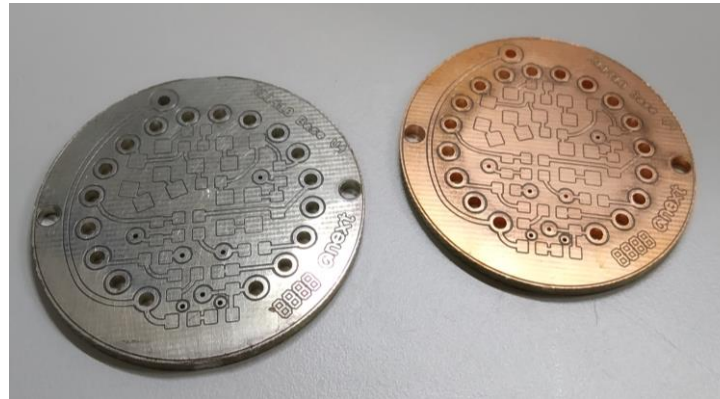
- Recubrimiento de circuitos con laca dieléctrica, kapton y estaño en frío



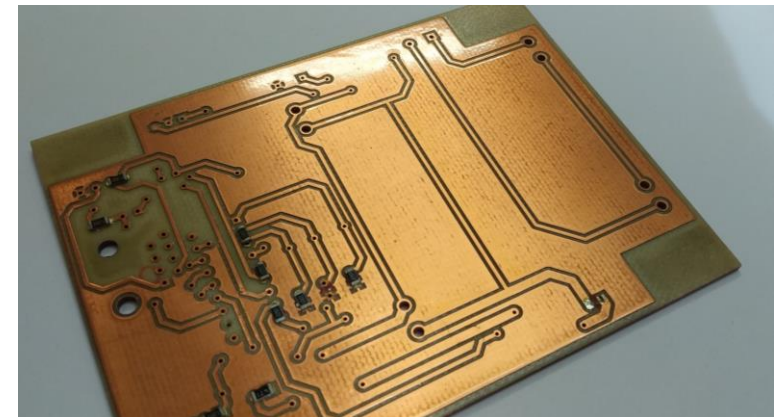
Antares



Física Médica



Next





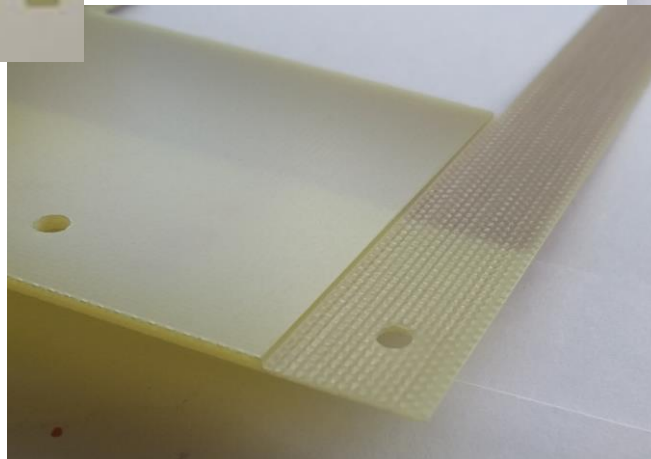
Fabricación de pequeñas piezas con CNC



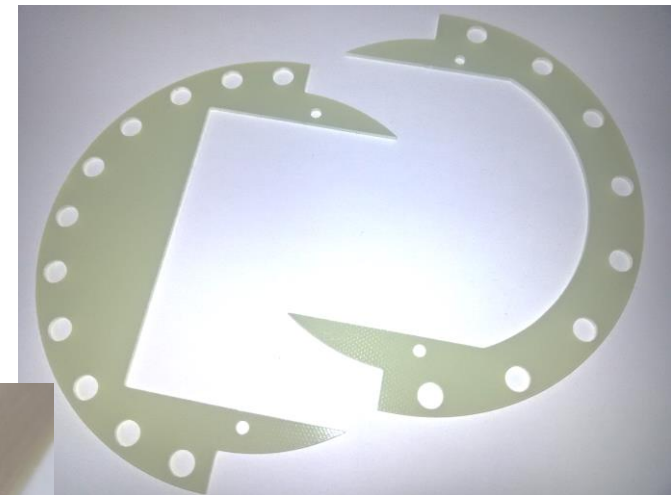
- Fabricación de pequeñas piezas en materiales FR4, piezas de soporte
- Rebaje de piezas en Z



Dune



Silicio

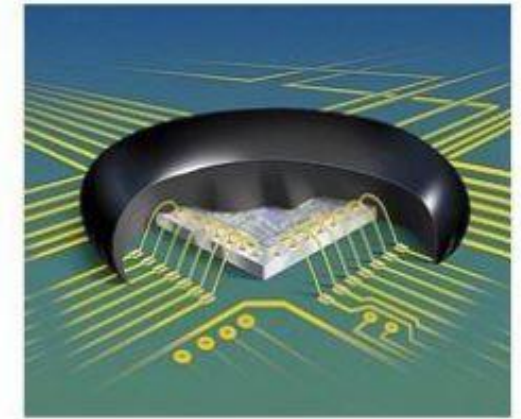
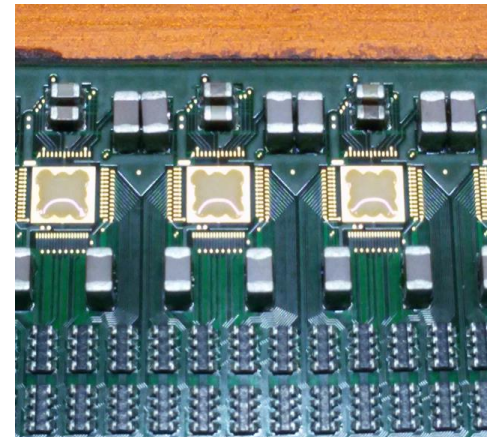


Dune



Ensamblaje de tarjetas con máquina Pick&place

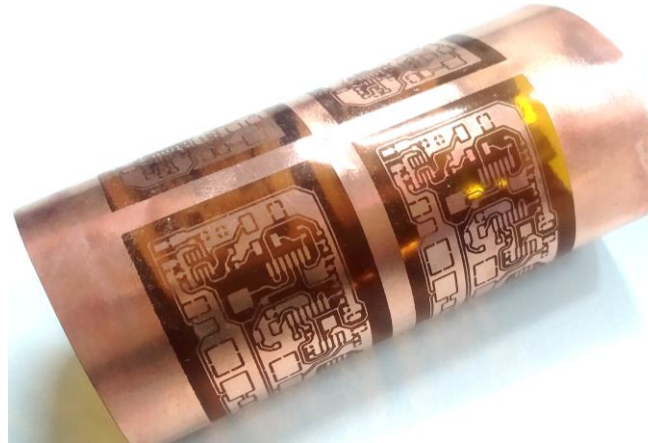
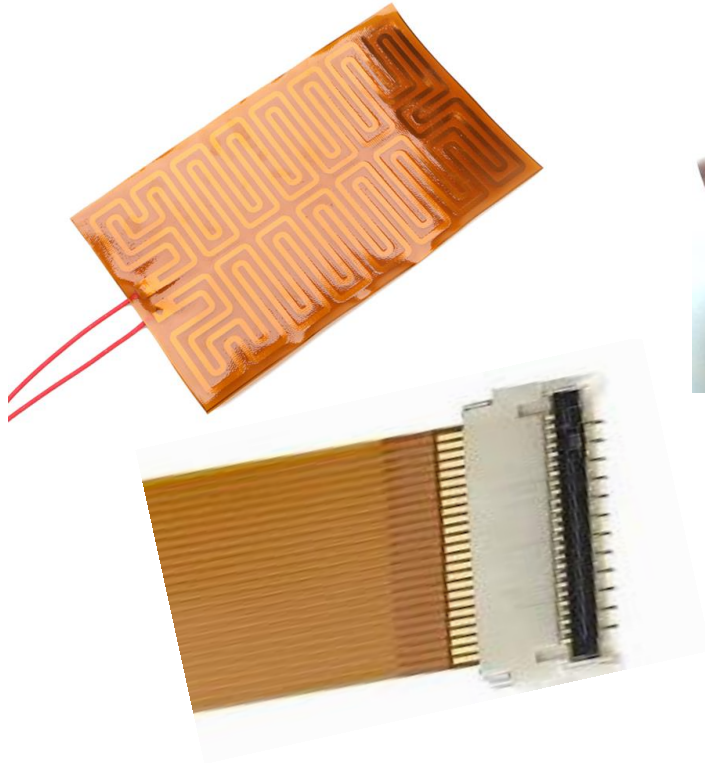
- Montaje de componentes en tarjetas
- Dispensación de pasta de soldadura y pegamento
- Encapsulado de circuitos integrados





Circuitos flexibles

- Fabricación de circuitos flexibles en cobre-kapton
- 1 cara
- 2 caras en futuro...metalización vías???
- Interconexión entre placas, cables, heaters, etc.
- Otros materiales



ETSE

